

Sitzung: **Expertentreffen „Konsumelektronik im Automobil – Möglichkeiten und Grenzen der Aufbau- und Verbindungstechnik.“**

Termin: **19. und 20. Februar 2018**

Ort: **Frankfurt am Main**

Montag, 19. Februar 2018 Beginn 20:00 Uhr:	
Dinner mit Vortrag	<i>Vorabendveranstaltung mit Vortrag Trends und Herausforderungen der AVT im Anwendungssegment „Automobile“ Andreas Aal, VW</i>

Dienstag, 20. Februar 2018 Beginn 8:00 Uhr: Registrierung, Empfang & Kaffee		
Begrüßung und Eröffnung	<i>Dr. Reinhold Ortmann Vorsitzender der FA AVT der FG MST</i>	9:00 Uhr
Main Challenges/Roadmaps in Packaging in Consumer, Industrial and Automotive Applications	<i>Jean-Christophe Eloy Yole Développement</i>	9:20 Uhr
Fact Sheet – Truly Different: Automotive Semiconductor and Consumer Components	<i>Stephan Lehmann NXP Semiconductor Germany</i>	9:50 Uhr
Robustness Validation	<i>Dieter Wagner, Continental Automotive</i>	10:20 Uhr
Kaffeepause mit Gesprächen		10:50 Uhr
Wie zuverlässig sind Zuverlässigkeitsprognosen an Konsumer Komponenten für den automobilen Einsatz?	<i>Prof. Dr. Sven Rzepka Fraunhofer ENAS</i>	11:15 Uhr
Vergleich optische thermomechanische Spannungsanalyse mit Simulation	<i>Dr. Rainer Dudek Fraunhofer ENAS</i>	11:45 Uhr
Mittagessen		12:15 Uhr

Optische thermomechanische Spannungsanalyse an Leiterplatte und Montage	<i>Dr. Thomas Fries FRT</i>	13:15 Uhr
Laserschweißen erhöht die AVT-Zuverlässigkeit	<i>Christan Braun Continental Automotive</i>	13:45 Uhr
Kaffeepause mit Gesprächen		14:15 Uhr
AVT bei Druckensoren	<i>Dr. Tim Behrens, Robert Bosch</i>	14:40 Uhr
Neue Mikro-Verbindungen mit Nano-Klettverschlüssen	<i>Prof. Dr-Ing. Helmut Schlaak Nano Wired</i>	15:10 Uhr
Gesprächs-Diskussions-Pause inkl. Kaffee		15:40 Uhr
Ende der Veranstaltung		16:00 Uhr